



联发科发布 AI 移动芯片，Q2 服务器存储或维持涨价 ——电子行业周报（2024.05.06-2024.05.10）

增持(维持)

行业： 电子
日期： 2024年05月13日
分析师： 陈宇哲
E-mail: chenyzhe@yongxings.com
SAC 编号： S1760523050001

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

算力芯片：联发科发布了天玑 9300 + 5G 生成式 AI 移动芯片，算力芯片产业加速发展。天玑 9300+拥有生成式 AI 能力，率先在端侧支持 AI 推测解码加速技术，同时支持天玑 AI LoRA Fusion 2.0 技术，支持前沿主流的生成式 AI 大模型。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

HBM：集邦咨询称 2025 年 HBM 价格或调涨约 5~10%，相关产业链或将受益。TrendForce 集邦咨询称 2024 年第二季已开始针对 2025 年 HBM 进行议价，供应商已经初步调涨 5~10%，包含 HBM2e，HBM3 与 HBM3e。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

先进封装：台积电 2024、2025 两年先进封装产能或已被英伟达、AMD 包下，先进封装产业链有望持续受益。英伟达、AMD 两家公司包下台积电今明两年 CoWoS 与 SoIC 先进封装产能。2024 年底台积电的 CoWoS 月产能将达到 4.5 万至 5 万片。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

存储芯片：CFM 称 Q2 服务器 NAND 涨幅或达 25%-30%、DRAM 涨幅或达 10%-20%，产业链有望持续受益。企业级 NAND 方面整体处于供不应求态势，二季度涨幅达到 25%-30%。服务器 DRAM 方面，受益于来自 AI 服务器的新增需求，二季度服务器 DRAM 涨幅有望达到 10%-20%。我们认为，随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周（5.6-5.10），A 股申万电子指数下跌 0.89%，整体跑输沪深 300 指数 2.61pct，跑输创业板综指数 1.87pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：电子化学品 II(0.37%)、消费电子(-0.42%)、元件(-0.71%)、光学光电子(-1.12%)、半导体(-1.14%)、其他电子 II(-1.5%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(2.13%)、费城半导体(1.95%)、道琼斯美国科技(1.48%)、纳斯达克(1.14%)、恒生科技(-0.23%)、申万电子(-0.89%)。

投资建议

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线。

算力芯片：英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

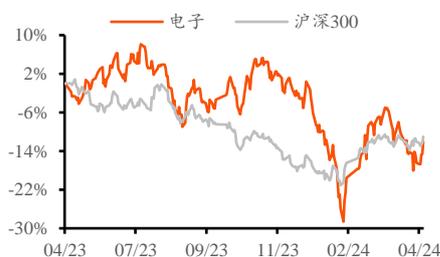
先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

- 《进迭时空发布 AI CPU 芯片，SK 海力士称 HBM 售罄》
——2024 年 05 月 06 日
- 《高通推出骁龙 X Plus，日月光称先进封装供不应求》
——2024 年 04 月 29 日
- 《台积电与 SK 海力士共推 HBM，Q2 原厂 SSD 或涨价》
——2024 年 04 月 23 日

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	7
3. 行业新闻	8
4. 公司动态	10
5. 公司公告	11
6. 风险提示	11

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (5.06-5.10)	5
图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (5.06-5.10)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (5.06-5.10)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (4.29-5.3)	6

表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (5.06-5.10)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (5.06-5.10)	11

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点:

算力芯片：联发科发布了天玑 9300 + 5G 生成式 AI 移动芯片，算力芯片产业加速发展。根据 IT 之家报道，联发科正式发布了天玑 9300 + 5G 生成式 AI 移动芯片。天玑 9300+ 采用全大核 CPU 架构，八核 CPU 包含 4 个 Cortex-X4 超大核，最高频率可达 3.4 GHz，以及 4 个主频为 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核。它还拥有强大的生成式 AI 能力，率先在端侧支持 AI 推测解码加速技术，同时支持天玑 AI LoRA Fusion 2.0 技术，提供更高效和个性化的生成式 AI 体验。天玑 9300 + 更支持前沿主流的生成式 AI 大模型，可为用户提供文字、图像、音乐等端侧生成式 AI 多模态创新体验。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

HBM：集邦咨询称 2025 年 HBM 价格或调涨约 5~10%，相关产业链或将受益。根据科创板日报援引 TrendForce 集邦咨询，2024 年第二季已开始针对 2025 年 HBM 进行议价，不过受限于 DRAM 总产能有限，为避免产能排挤效应，供应商已经初步调涨 5~10%，包含 HBM2e，HBM3 与 HBM3e。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

先进封装：台积电 2024、2025 两年先进封装产能或已被英伟达、AMD 包下，先进封装产业链有望持续受益。根据 IT 之家援引中国台湾经济日报报道，英伟达、AMD 两家公司重视高性能计算（HPC）市场，包下台积电今明两年 CoWoS 与 SoIC 先进封装产能。台积电正在积极扩充先进封装产能。2024 年底台积电的 CoWoS 月产能将达到 4.5 万至 5 万片，SoIC 预计 2024 年底月产能可达五、六千片，并在 2025 年底冲上单月 1 万片规模。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

存储芯片：CFM 称 Q2 服务器 NAND 涨幅或达 25%-30%、DRAM 涨幅或达 10%-20%，产业链有望持续受益。根据 CFM 闪存市场报道，企业级 NAND 方面，新制程产品仍在导入验证过程中，由于企业级产品验证周期较长，加上新制程工艺也需时间进行产能爬坡，预计到 Q4 甚至 2025 年才能完全导入完成。因此，整体处于供不应求态势，终端客户对涨价也有预期，二季度涨幅达到 25%-30%，至 0.12 美元/GB。服务器 DRAM 方面，从 DDR4 向 DDR5 制程切换的步伐坚定，DDR4 产能释出必定逐渐减少。受益于来自 AI 服务器的新增需求，原厂正积极推动 DDR5 产能快速爬坡，扩大 32Gb DDR5 高容量颗粒供应，结合支持 DDR5 的新型处理器平台产能正在爬坡，在服务器端整体技术迭代和产品升级的趋势下，下半年 DDR5 服

务器端渗透率有望超过 50%。整体来看，二季度服务器 DRAM 涨幅有望达到 10%-20%。我们认为，随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

投资建议：

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线。

算力芯片：英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等。

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

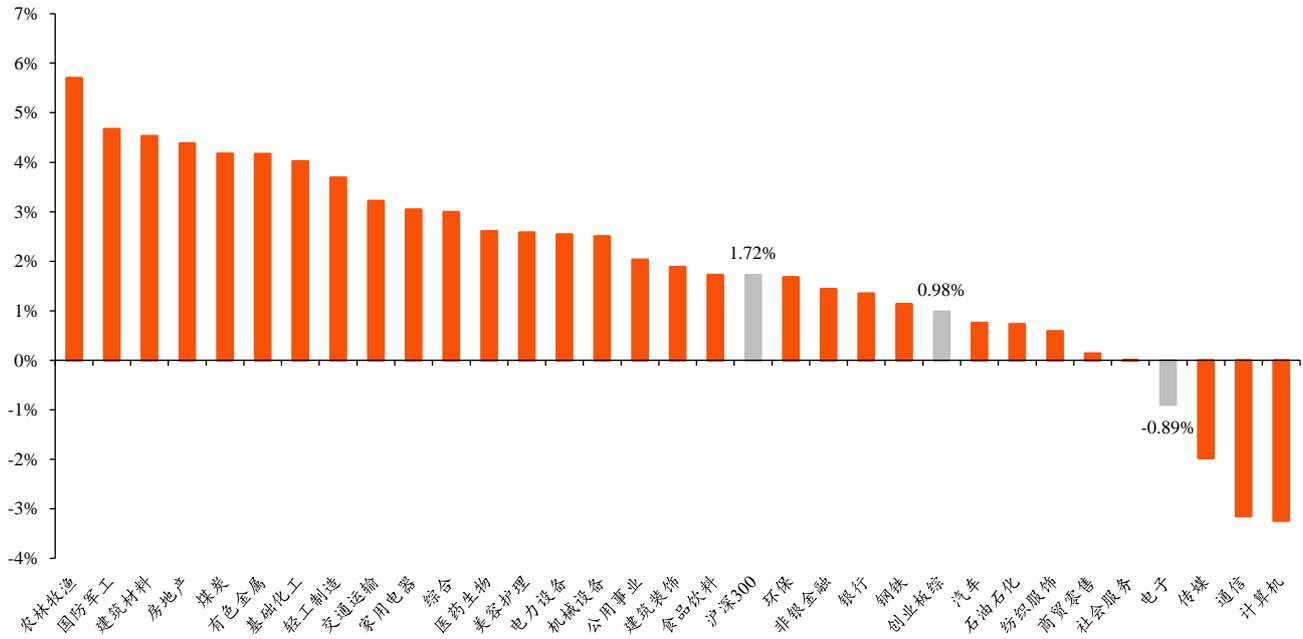
存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周（5.6-5.10），A股申万电子指数下跌0.89%，板块整体跑输沪深300指数2.61pct，跑输创业板综指数1.87pct。在申万31个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第28位。

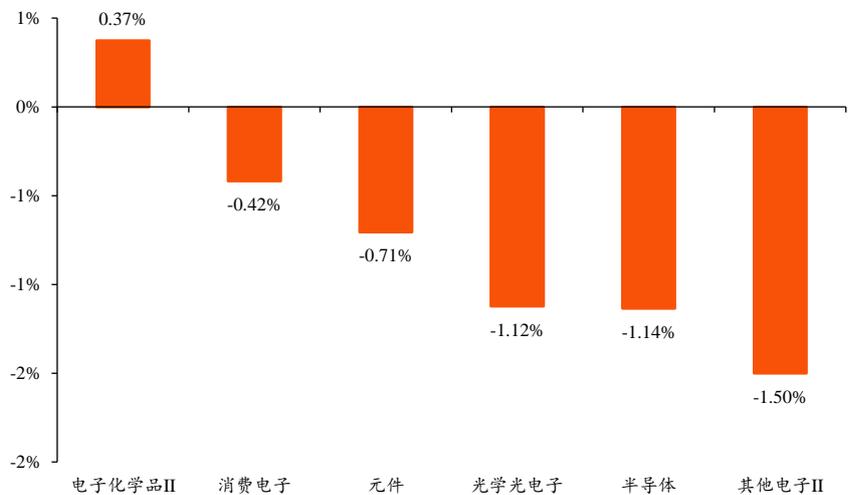
图1:A股申万一级行业涨跌幅情况(5.06-5.10)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（5.6-5.10）申万电子二级行业中，电子化学品II板块上涨0.37%，表现较好；其他电子II板块下跌1.5%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：电子化学品II(0.37%)、消费电子(-0.42%)、元件(-0.71%)、光学光电子(-1.12%)、半导体(-1.14%)、其他电子II(-1.5%)。

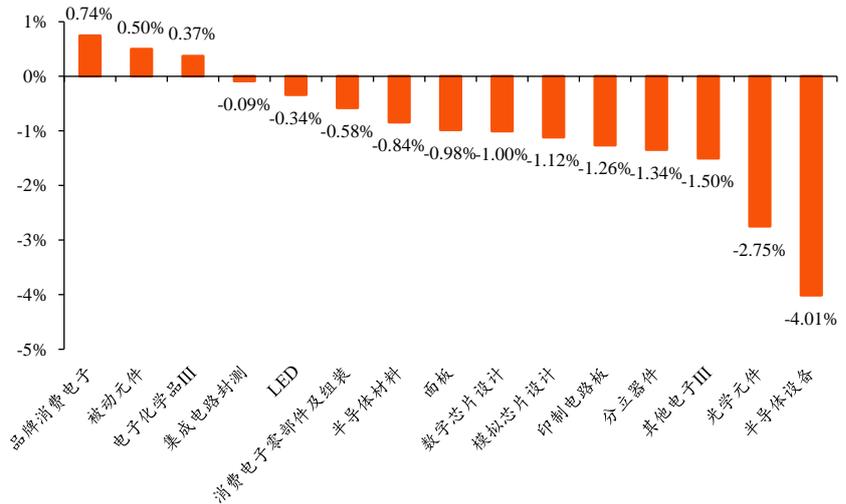
图2:A股申万二级行业涨跌幅情况(5.06-5.10)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（5.6-5.10）申万电子三级行业中，品牌消费电子板块上涨 0.74%，表现较好；半导体设备板块下跌 4.01%，表现较差。表现靠前的板块分别为：品牌消费电子(0.74%)、被动元件(0.50%)、电子化学品III(0.37%)。表现靠后的板块分别为：半导体设备(-4.01%)、光学元件(-2.75%)、其他电子III(-1.5%)。

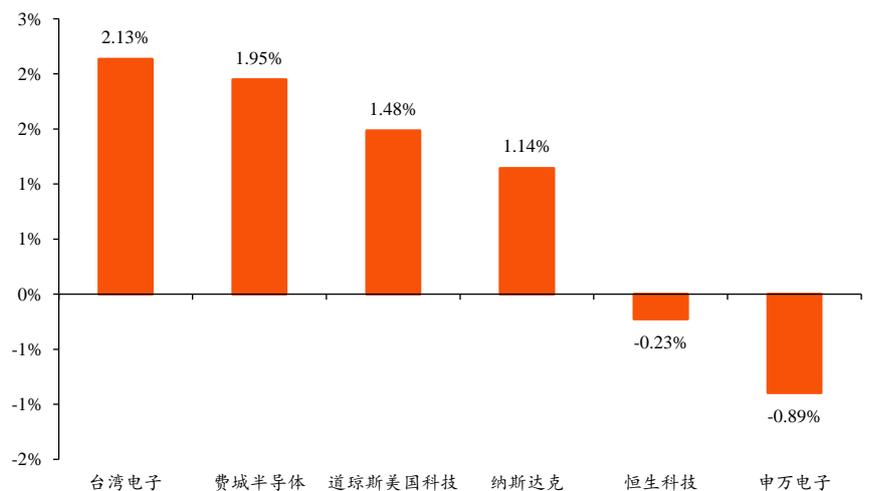
图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（5.06-5.10）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（5.6-5.10），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(2.13%)、费城半导体(1.95%)、道琼斯美国科技(1.48%)、纳斯达克(1.14%)、恒生科技(-0.23%)、申万电子(-0.89%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（4.29-5.3）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周（5.6-5.10）个股涨跌幅前十位分别为：宝明科技（+25.49%）、濮阳惠成（+19.31%）、久量股份（+16.55%）、鹏鼎控股（+12.68%）、福日电子（+10.73%）、伊戈尔（+10.28%）、长阳科技（+9.3%）、金海通（+9.18%）、江海股份（+7.45%）、景旺电子（+7.23%）。个股涨跌幅后十位分别为：贤丰控股（-22.77%）、华微电子（-22.58%）、超华科技（-22.54%）、合力泰（-14.84%）、ST 宇顺（-9.86%）、沃尔核材（-9.41%）、芯原股份（-9.1%）、源杰科技（-9.06%）、格科微（-8.62%）、东田微（-8.48%）。

表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（5.06-5.10）

周涨跌幅前 10 名			周涨跌幅后 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
002992.SZ	宝明科技	25.49%	002141.SZ	贤丰控股	-22.77%
300481.SZ	濮阳惠成	19.31%	600360.SH	华微电子	-22.58%
300808.SZ	久量股份	16.55%	002288.SZ	超华科技	-22.54%
002938.SZ	鹏鼎控股	12.68%	002217.SZ	合力泰	-14.84%
600203.SH	福日电子	10.73%	002289.SZ	ST 宇顺	-9.86%
002922.SZ	伊戈尔	10.28%	002130.SZ	沃尔核材	-9.41%
688299.SH	长阳科技	9.30%	688521.SH	芯原股份	-9.10%
603061.SH	金海通	9.18%	688498.SH	源杰科技	-9.06%
002484.SZ	江海股份	7.45%	688728.SH	格科微	-8.62%
603228.SH	景旺电子	7.23%	301183.SZ	东田微	-8.48%

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

3. 行业新闻

集邦咨询：2025 年 HBM 价格调涨约 5~10%

5月6日消息，根据科创板日报援引 TrendForce 集邦咨询，2024 年第二季已开始针对 2025 年 HBM 进行议价，不过受限于 DRAM 总产能有限，为避免产能排挤效应，供应商已经初步调涨 5~10%，包含 HBM2e，HBM3 与 HBM3e。

资料来源：(科创板日报)

CFM 闪存市场：Q2 服务器与消费类市场分化加大，预计下半年行情平稳向上发展

5月8日消息，根据 CFM 闪存市场报道，由于国内互联网厂商与服务器 OEM 厂商对 AI 服务器投资步伐差异，对存储产品需求态度已经出现分化。从二季度目前的市况来看，海内外互联网为首的科技企业正积极投资 AI 服务器，带动服务器市场内存需求回升，部分服务器客户对涨价的接受度也较高。不过值得注意的是，由于国内部分核心硬件供应受阻，一定程度上阻碍了 AI 服务器的应用增长，以及国内部分 OEM 厂商面临传统需求不佳、库存水位上升的情况，因此后续更大范围的涨幅落地，仍需结合实际情况而定。原厂态度仍然一以贯之，保证利润仍是首要目标。企业级 NAND 方面，新制程产品仍在导入验证过程中，由于企业级产品验证周期较长，加上新制程工艺也需时间进行产能爬坡，预计到 Q4 甚至 2025 年才能完全导入完成。因此，整体处于供不应求态势，终端客户对涨价也有预期，二季度涨幅达到 25%-30%，至 0.12 美元/GB。服务器 DRAM 方面，从 DDR4 向 DDR5 制程切换的步伐坚定，DDR4 产能释出必定逐渐减少。受益于来自 AI 服务器的新增需求，原厂正积极推动 DDR5 产能快速爬坡，扩大 32Gb DDR5 大容量颗粒供应，结合支持 DDR5 的新型处理器平台产能正在爬坡，在服务器端整体技术迭代和产品升级的趋势下，下半年 DDR5 服务器端渗透率有望超过 50%。整体来看，二季度服务器 DRAM 涨幅有望达到 10%-20%。

资料来源：(CFM 闪存市场)

联发科：天玑 9300+ 芯片发布，AI 先锋计划启动

5月7日消息，根据 IT 之家报道，联发科正式发布了天玑 9300+ 5G 生成式 AI 移动芯片。天玑 9300+ 采用全大核 CPU 架构，八核 CPU 包含 4 个 Cortex-X4 超大核，最高频率可达 3.4 GHz，以及 4 个主频为 2.0GHz 的 Cortex-A720 大核。它还拥有强大的生成式 AI 能力，率先在端侧支持 AI 推测解码加速技术，同时支持天玑 AI LoRA Fusion 2.0 技术，提供更高效和个性化的生成式 AI 体验。天玑 9300+ 更支持前沿主流的生成式 AI 大模型，可为用户提供文字、图像、音乐等端侧生成式 AI 多模态创新体验。同时，

它还支持 AI 框架 ExecuTorch，可加速端侧生成式 AI 应用的开发进程。

资料来源：(IT之家)

台积电 2024、2025 两年先进封装产能或已被英伟达、AMD 包下

5 月 6 日消息，根据 IT 之家援引中国台湾经济日报报道，英伟达、AMD 两家公司重视高性能计算（HPC）市场，包下台积电今明两年 CoWoS 与 SoIC 先进封装产能。台积电对 AI 相关应用的发展前景充满信心，总裁魏哲家在 4 月份的财报会议上调整了 AI 订单的预期和营收占比，订单预期从原先的 2027 年延长到 2028 年。台积电认为，2024 年 AI 服务器将会带来翻倍的营收增长。他们预测，未来五年 AI 服务器的年复合增长率将达到 50%，到 2028 年将占台积电营收的 20% 以上。全球云服务公司正在积极投入 AI 服务器军备竞赛。英伟达、AMD 的产品供不应求，他们全力向台积电下单，以应对云服务公司的大量订单需求。为应对客户的巨大需求，台积电正在积极扩充先进封装产能。2024 年底台积电的 CoWoS 月产能将达到 4.5 万至 5 万片，SoIC 预计 2024 年底月产能可达五、六千片，并在 2025 年底冲上单月 1 万片规模。英伟达目前的主力产品 H100 芯片主要采用台积电 4 纳米制程，并采用 CoWoS 先进封装，与 SK 海力士的高带宽内存（HBM）以 2.5D 封装形式提供给客户。AMD 的 MI300 系列则采用台积电 5 纳米和 6 纳米制程生产，与英伟达不同的是，AMD 先采用台积电的 SoIC 将 CPU、GPU 芯片做垂直堆叠整合，再与 HBM 做 CoWoS 先进封装。

资料来源：(IT之家)

4. 公司动态

【裕太微】公司 2.5G 网通以太网物理层芯片预计全年进一步放量

5月6日消息，裕太微在投资者互动平台表示，公司是中国境内极少数实现 2.5G 网通以太网物理层芯片规模量产的企业。在 5G 网络的推动下，2.5G 以太网系列产品在中国的时代即将开启。随着 10G PON 路由器和 5G 基站的应用数量与日俱增，2.5G 及以上速率的网通以太网物理层芯片需求量也逐步增加。这对于公司新品在未来三到五年的推广与应用带来了较大的市场机会。2.5G 网通以太网物理层芯片于 2023 年全年实现两千多万元的营收，于 2024 年第一季度实现一千多万元的营收，预计将在 2024 年全年进一步放量。

资料来源：（投资者互动平台）

【佰维存储】公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建

5月7日消息，佰维存储在投资者互动平台表示，公司产品价格主要受供需关系、市场竞争等多种因素决定。目前市场供需关系逐步改善，公司产品价格随行就市。公司产能利用率处于较高水平，包括手机存储芯片在内的各类订单需求增长，公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建，以满足客户的交付需求。

资料来源：（投资者互动平台）

【卓胜微】公司 6 英寸滤波器产线实现高良率批量生产

5月8日消息，卓胜微在投资者互动平台表示，公司 6 英寸滤波器产线目前已实现高良率的批量生产状态。未来公司仍会持续提高产线良率，优化成本结构。

资料来源：（投资者互动平台）

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告 (5.06-5.10)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/05/07	中一科技	利润分配	公司 2023 年年度权益分派拟: 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股
2024/05/07	锦富技术	股本变动	公司向特定对象发行股票限售股份本次解除限售数量为 2.05 亿股, 占公司目前总股本的 15.78%。可上市流通日为 2024 年 5 月 10 日(星期五)
2024/05/08	隆扬电子	股权激励	公司 2023 年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就, 公司审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 5 月 6 日, 本次授予数量为 24 万股, 授予价格为 9.30 元/股
2024/05/08	臻镭科技	利润分配	2023 年年度权益分派方案, 每股派发现金红利 0.17 元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股, 股权登记日为 5 月 15 日, 合计派发现金红利 2599.2 万元, 转增 61,157,600 股, 本次分配后总股本为 214,051,600 股
2024/05/09	共达电声	股份增持	4 月 29 日至 5 月 8 日, 股东无锡韦感半导体有限公司增持 366 万股公司股份, 占公司总股本的 1.0008%, 耗资 3926.47 万元
2024/05/10	商络电子	利润分配	公司 2023 年年度权益分派: 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本 628,531,355 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派 0.11 元人民币现金(含税)
2024/05/10	沪电股份	利润分配	以公司 2024 年 3 月 24 日的总股本 1,911,999,270 股为基数, 以截至 2023 年 12 月 31 日母公司的累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元(含税), 本次共拟分配现金 955,999,635.00 元

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。